

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

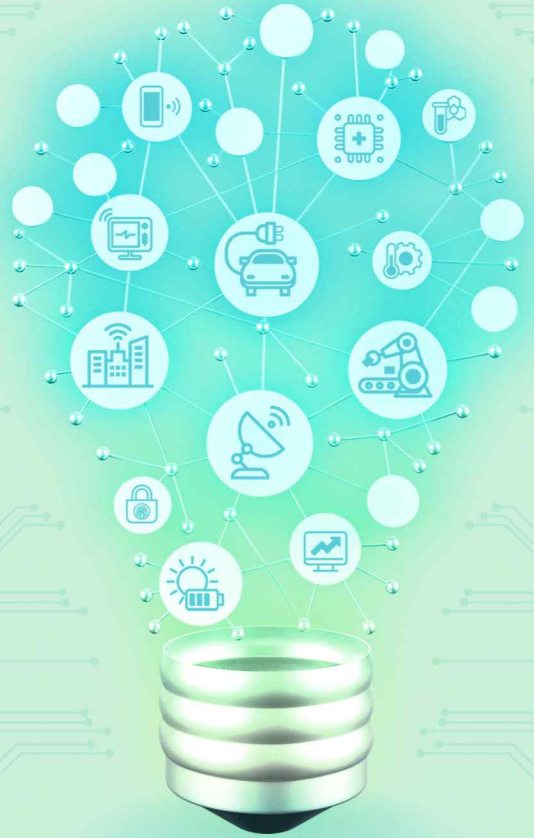
기술분석보고서

 YouTube 요약 영상 보러가기

원팩(097800)

반도체

요약
기업현황
재무분석
주요 변동사항 및 전망



작성기관

NICE평가정보(주)

작성자

최대웅 전문연구원

- 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술 신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.
- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미 게재 상태일 수 있습니다.
- 카카오톡에서 “한국IR협회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)으로 연락주시기 바랍니다.

원팩(097800)

반도체 패키징 및 테스트 전문기업

기업정보(2021/11/1 기준)

대표자	이한규
설립일자	2002년 04월 03일
상장일자	2013년 03월 07일
기업규모	중소기업
업종분류	발광 다이오드 제조업
주요제품	반도체 패키징 테스트, 제조, 판매

시세정보(2021/11/1 기준)

현재가(원)	2,395
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	1,192
발행주식수	42,910,385
52주 최고가(원)	3,185
52주 최저가(원)	1,650
외국인지분율	2.58%
주요주주	(주)티엘아이

■ 반도체 패키징 및 테스트 전문기업

원팩은 반도체 패키징 및 테스트 전문기업으로, 메모리 반도체 중 D램과 Flash 메모리를 주로 취급하고 있다. MCP(Multi Chip Package)를 활용한 하이엔드 반도체 패키징 기술개발과 생산역량 강화에 집중하고 있으며, 18 Stack 적층 기술, Wafer thin grinding 기술, 설계 기술, 다양한 MCP의 접합기술 등 지속적인 연구개발을 진행하고 있다.

■ 기존 고객사와 협력 관계 유지 및 신규 고객사 발굴

주 고객사는 에스케이하이닉스로 10년 이상 거래 관계를 지속하고 있으며, 영업, 기술, 제조, 품질 등 모든 분야에서 신속한 문제 처리를 통해 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다. 다만, 에스케이하이닉스와의 거래 비중이 약 61% 수준으로 의존도가 다소 높아 신규 고객사 발굴에 역량을 집중하고 있다. 이를 위해 보유하고 있는 기술력과 생산역량을 바탕으로 적극적인 영업 활동을 전개하고 있다.

■ 시스템 반도체 테스트 분야로 사업영역 확장

사업영역 확장과 거래처 다변화를 위해 시스템 반도체 테스트 분야로 사업 영역을 확장하고 있다. 반도체 산업이 다품종 소량생산 구조로 점차 변화되면서 다양한 제품의 양품과 불량품을 판별하는 테스트 전문 업체의 필요성이 대두되고 있는 상황에서 동사는 다양한 고객의 요구에 맞춰 테스트 라인을 증설, 확충하고 있다. 동사의 시스템 반도체 테스트 사업이 정상궤도에 올라 안정화될 경우 팹리스 업체들의 칩을 패키징부터 테스트까지 일괄 수주할 수 있는 역량을 갖추게 될 것으로 보인다.

요약 투자지표 (K-IFRS 개별 기준)

구분 년	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2018	675	43.2	24	3.6	15	2.2	4.2	2.0	101.9	43	1,030	29.6	1.2
2019	979	45.1	78	8.0	93	9.5	22.1	9.7	149.7	254	1,263	7.9	1.6
2020	1,101	12.4	53	4.9	51	4.7	10.4	4.1	158.3	137	1,357	13.6	1.4

기업경쟁력

반도체 패키징 및 테스트 전문기업

■ 패키징 분야

- 플립칩, 패키지 온 패키지, 임베디드멀티칩 패키지 등

■ 테스트 분야

- Probe test → PKG Assemble → Final test 일괄 공정 토달 서비스 제공

지속적인 연구개발로 패키징 분야 기술 선도

■ SDBG 6Gb LPDDR4를 적용한 4-Die Stack 24Gb(6Gb LPDDR4x4) Mobile용 200B 패키지 개발

■ Mobile-PAM(전력증폭모듈)용 3x3 20LGA SiP(4Die+4Comp.) 패키지 개발

■ C2 타입 CPB(Cu Pillar Bump) 플립칩 Controller를 적용한 128GB ROM/6GB RAM(10nm세대) 8단 uMCP(UFS+LPDDR4X) 패키지 개발

핵심기술 및 취급 품목

핵심기술

■ MCP(Multi Chip Package)를 활용한 하이엔드 반도체 패키징 기술

■ 플립칩(Flip chip), 패키지 온 패키지(POP) 선제적 투자를 통한 인프라 구축

■ 고객사의 제시 기준에 따른 테스트 기술

주요제품

패키징 제품



스토리지 제품



ESG 현황

Environment

항목	현황
환경 정보 공개	☑
환경 경영 조직 설치	☑
환경 교육 수준	☑
환경 성과 평가체계 구축	☐
온실가스 배출	☐
에너지, 용수 사용	☐
신재생 에너지	☐

☑ : 양호 ☒ : 미흡 ☐ : 확인불가

Social

항목	현황
인권보호 정책 보유	☐
여성/기간제 근로자 근무	☑
협력사 지원 프로그램	☐
공정거래/반부패 프로그램	☐
소비자 안전 관련 인증	☐
정보보호 안전 관련 인증	☐
사회공헌 프로그램	☐

☑ : 양호 ☒ : 미흡 ☐ : 확인불가

Governance

항목	현황
주주의결권 행사 지원제도	☑
중장기 배당정책 보유	☑
이사회 내 사외이사 보유	☑
대표이사회 독립성	☑
감사위원회 운영	☑
감사 업무 교육 실시	☒
지배구조 정보 공개	☑

☑ : 양호 ☒ : 미흡 ☐ : 확인불가

- ▶ 당사는 홈페이지에 환경 관련 정보를 공개하고 내부환경관리 조직을 운영하고 있으며, 관련 교육을 실시하고 있음.
- ▶ 여성 근로자 근무 등을 진행하고 있으나, 협력사 지원 프로그램, 사회공헌 프로그램 등은 확인 불가함.
- ▶ 이사회 내 사외이사 비중이 약 30%로, 이사회 독립성을 확보하고 있으며, 감사위원회를 운영하고 있으나, 감사 업무 교육은 실시하고 있지 않음.

* 본 ESG현황은 나이스평가정보평가 분석대상 기업으로 입수한 정보를 요약 정리한 것으로, 분석 시점 및 기업의 변화도에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

I. 기업현황

반도체 패키징 및 테스트 종합 솔루션 구축 전문기업

원팩(이하 동사)은 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 패키징 및 테스트 사업을 영위하고 있으며, 반도체 제조사로부터 후공정을 일괄 수주할 수 있는 인프라를 구축하였다.

■ 개요 및 사업 현황

동사는 2002년 4월 반도체 외주생산 서비스 및 반도체 제조, 생산, 판매업을 주요 사업 목적으로 설립되었다. 2013년 3월 코스닥시장에 상장되었으며, 현재 반도체 후공정인 패키징 및 테스트 외주사업을 진행하고 있다. 경기도 용인시 소재에 본사를 두고 있으며, 2021년 6월 기준 462명의 임직원이 근무하고 있다.

2021년 반기보고서 기준, 동사의 최대주주는 (주)티엘아이로 14.53%의 지분을 보유하고 있으며, 김달수((주)티엘아이 대표이사)가 3.04%, (주)센소니아가 2.80%, 이한규(대표이사)가 1.81%의 지분을 보유하고 있다.

대표이사는 이한규로 2016년 2월 선임되어 현재까지 경영총괄 업무를 수행하고 있다. 한국항공대학교 전자공학과를 전공하여 주요 사업 관련 전문성을 보유하고 있으며, 에스케이하이닉스 제조기술팀장, (주)티엘아이 생산총괄 전무이사 등을 역임했다.

표 1. 주요주주 및 계열회사 현황

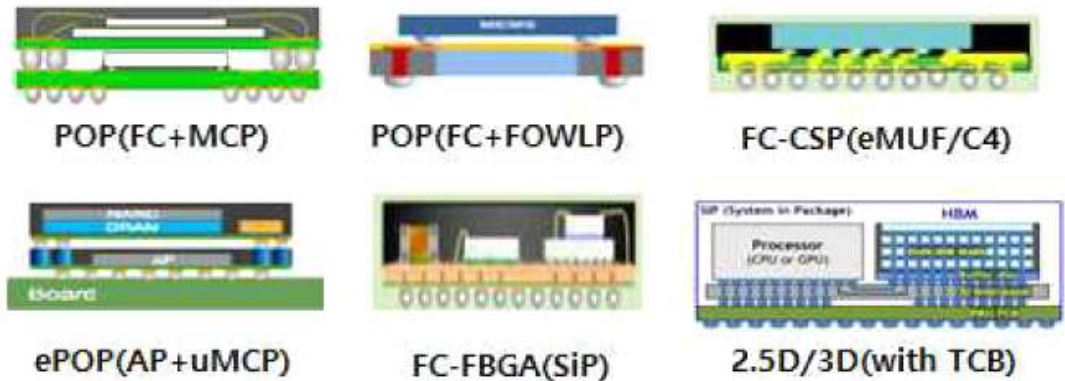
주요주주	지분율(%)	출자 타인법인	지분율(%)
(주)티엘아이	14.53	(주)티더블유메디칼	22.9
김달수	3.04	Transdermal Specialties Global, Inc.,	7.5
(주)센소니아	2.80	-	-
이한규	1.81	-	-

*출처: 반기보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

■ 보유기술 및 주요제품 현황

동사는 메모리 반도체 중 D램과 Flash 메모리를 주로 취급하고 있다. 반도체 후공정에 참여하는 업체들은 패키징 기술, 테스트 기술, 양산능력, 고품질, 안정화, 대규모 설비 등에 사업 인프라를 확보하는 것이 필수적이다. 동사는 고부가가치 제품 위주의 제품을 개발하고 있으며, 신규 패키징 기술개발을 통해 신제품 수주에 집중하고 있다. MCP를 활용한 하이엔드 반도체 패키징 기술개발과 생산역량 강화에 집중하고 있으며, 18 Stack 적층 기술, Wafer thin grinding 기술, 설계 기술, 다양한 MCP의 접합기술 등 지속적인 연구개발을 진행하고 있다.

그림 1. 주요 고부가가치 제품 현황



*출처: WSTS(2021), NICE평가정보(주) 재구성

2021년 반기보고서 기준 전체 매출 중 패키징에 의한 매출은 78.62%이며, 테스트에 의한 매출은 20.79% 조사되었다. 주 고객사는 에스케이하이닉스로 10년 이상 거래 관계를 지속하고 있으며, 전체 매출의 약 61%를 차지하고 있다. 협력 관계 유지를 위해 문제 발생 시 신속하고 유기적인 처리를 진행하고 있다.

표 2. 매출 현황(단위: 백만 원)

매출유형	구분	2021년 반기		2020년		2019년	
		매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
제품	패키징	37,719	78.62%	84,481	76.73%	75,250	76.84%
용역	테스트	10,103	20.79%	24,341	22.11%	21,960	22.43%
	상품	773	1.59%	1,273	1.16%	717	0.73%
	합계	48,595	100.00%	110,095	100.00%	97,927	100.00%

*출처: 반기보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

■ 연구개발 이력

동사는 인정받은 기업부설연구소를 2005년 05월에 설립하여 미래기술팀과 공정기술팀으로 운영하고 있다. 2021년 반기보고서 기준 매출액 대비 연구개발비용 비율은 0.4% 수준으로 높지 않으나, 23명의 연구개발 인력을 보유하고 있으며, 기술 확보, 생산성 증대 등의 목적으로 관련 기술개발을 위해 ‘V5 512Gb 3D-Nand WF에 50um SDBG와 C-mold공정을 적용한 메인스트림 스토리지 F132 패키지 개발(SSD용 256GB)’, ‘Mobile-PAM(전력증폭모듈)용 3x3 20LGA SiP(4Die+4Comp.) 패키지 개발’ 등 다수의 연구개발 과제를 진행하고 있다.

표 3. 연구개발비용(단위: 천 원)

구분		2021년 반기	2020년	2019년
비용처리	제조원가	-	-	-
	판관비	214,249	455,231	386,164
연구개발비용 합계		214,249	455,231	386,164
(매출액 대비 비율)		0.4%	0.4%	0.4%

*출처: 반기보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

표 4. 최근 연구개발 실적

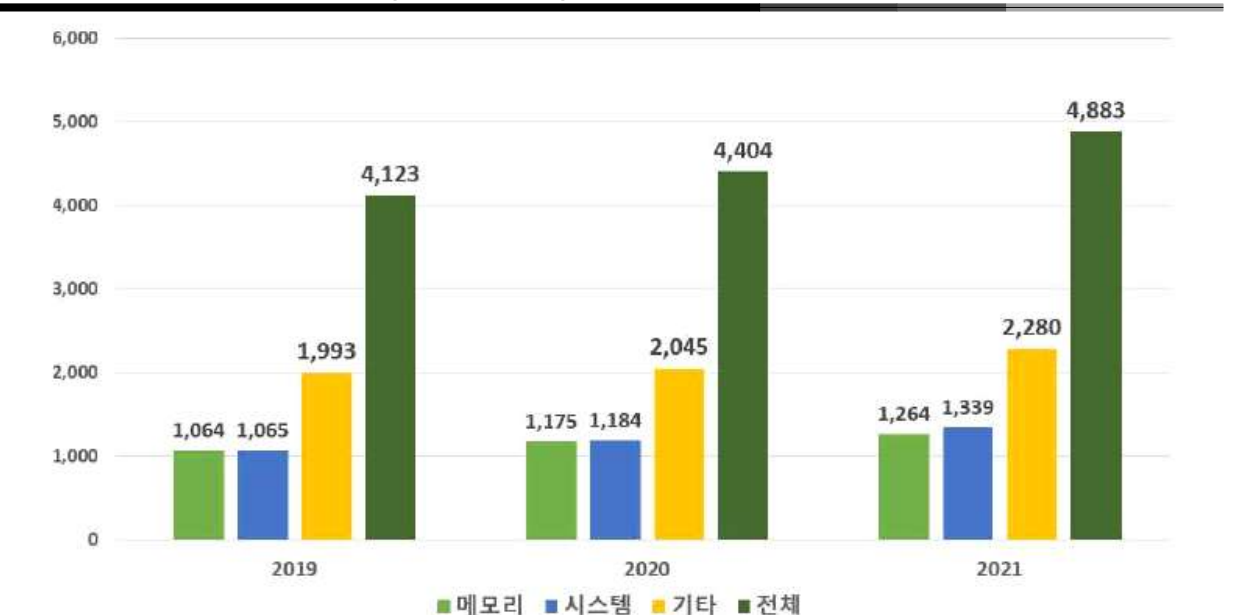
연구과제	종료일
V5 512Gb 3D-Nand WF에 50um SDBG와 C-mold공정을 적용한 메인스트림 스토리지 F132 패키지 개발(SSD용 256GB)	진행중
C2 타입 CPB(Cu Pillar Bump) 플립칩 Controller를 적용한 64GB ROM/6GB RAM(10ny세대) 7단 uMCP(UFS+LPDDR4)패키지 개발	진행중
5G 통신용 High Speed Switching SPDT를 적용한 3x3-13LGA 패키지 개발	2021.06
32Gb(4GB) NAND+4Gb LPDDR4 적용한 8GBROM/1GBRAM 보급형 149B(4Stack) eMCP 패키지 개발	진행중
10ny세대 60um SDBG 공정이 적용된 4-Die Stack 32Gb(8Gb LPDDR4x4) Mobile용 200B 패키지 개발	2021.06
C2 타입 CPB(Cu Pillar Bump) 플립칩 Controller를 적용한 128GB ROM/6GB RAM(10ny세대) 8단 uMCP(UFS+LPDDR4X)패키지 개발	2021.06
Mobile-PAM(전력증폭모듈)용 3x3 20LGA SiP(4Die+4Comp.) 패키지 개발	2021.06
SDBG 6Gb LPDDR4를 적용한 4-Die Stack 24Gb(6Gb LPDDR4x4) Mobile용 200B 패키지 개발	2021.02

*출처: 반기보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

■ 시장 현황 및 경쟁사 현황

세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면 세계 반도체 시장규모는 2020년 4,404억 달러에서 2021년 4,883억 달러로 성장하였다. 2020년 기준으로 전 세계반도체 산업에서 메모리 반도체는 1,175억 달러로 33%, 시스템 반도체는 1,184억 달러로 33%를 차지하고 있다. 그 외에는 마이크로, 아날로그, 센서, 옵토, 디스크리트 순으로 점유율을 차지하고 있다.

그림 2. 세계 반도체 시장 규모(단위: 억 달러)



*출처: WSTS(2021), NICE평가정보(주) 재구성

반도체 패키징 사업을 영위하고 있는 국내 주요 경쟁사들은 Amkor Korea, ASE, SFA반도체, 시그네틱스, 하나마이크론, 에이티세미콘 등이 있으며, 테스트 분야에는 에이티세미콘, 하이셈, 테스나, ASE 등이 참여하고 있다.

■ 기술사업 분석

최근에는 미국의 반도체 산업 육성, 중국의 반도체 국산화 등 움직임으로 인해 공정별로 국제적 분업화가 이뤄졌던 반도체 산업이 자국 내 분업체계를 구축하고자 하는 움직임으로 변화하고 있다. 이러한 반도체 산업의 글로벌 공급망 재편과 패키징 기술의 발전 등에 대응한 제품개발 및 판매처 확보 전략이 필요할 것으로 판단된다.

특히 국내에서는 삼성전자나 네패스 등 일부 기업만이 첨단 패키징 기술인 팬아웃이나 웨이퍼 레벨 패키징, 패널레벨 패키징 사업을 진행 중인 것으로 알려져 있는데, 팬아웃 패키징 시장에서 국내 기업의 점유율은 3% 미만(TSMC 66.9%, ASE 20%) (Yole Development, 2020) 수준이며, 최근 글로벌 반도체 공급망 재편 이슈가 불거지면서 2016년 TSMC의 팬아웃 패키징 도입에 따른 AP(Application Processor) 시장 영향력 확대 사례가 자주 거론되는 만큼, 동사를 포함한 국내 반도체 업체들의 첨단 패키징 기술역량 확보가 중요한 요인으로 작용할 것으로 판단된다.

II. 재무 분석

매출 성장세이나 재무적 위험은 주시 필요

동사는 코로나19라는 악재에도 불구하고 견조한 매출 성장을 유지했으나, 올해 상반기 실적은 적자 시현했고 높은 재무레버리지가 지속되고 있어 유동성 위험에 대한 지속적인 관리가 필요하다.

■ 수출 위주로 견조한 매출 성장세

동사는 2020년 개별 결산기준 SK하이닉스 신규 제품(Flip Chip)증가 및 거래선 다변화에 따른 고객사 수주물량 확대로 전년 대비 12.4% 증가한 1,101억 원의 매출을 기록하였다. 사업 부문별로 살펴보면 패키징 부문이 845억 원(+12.3% YoY), 테스트 부문에서 243억 원(+10.8% YoY)을 각각 기록하며 총매출 성장을 이끌었다.

내수 매출의 경우 180억 원(+20.7% YoY)으로 최근 수 년간 200억 원 내외를 횡보하고 있는 반면, 수출 매출은 921억 원(+10.9% YoY)으로 꾸준히 성장하며 동사 매출에 기여하고 있다. 당기의 경우 수출 매출 비중이 83.7%였고, 2019년이 84.8%, 2018년 72.8%, 2017년이 56.0%로 매년 확대되는 유의적인 변화를 보여주고 있다.

그림 3. 동사 연간 및 상반기 요약 포괄손익계산서 분석



*출처: 동사 사업보고서(2020), 반기보고서(2021)

■ 업계 대비 무난한 수익성 시현

수익성 측면에서는 원재료비 증가와 종업원급여 상승, 시설투자에 따른 감가상각 비용 증가 등으로 전년 대비 저하된 매출액영업이익률 4.9%, 매출액순이익률 4.7%를 기록했다.

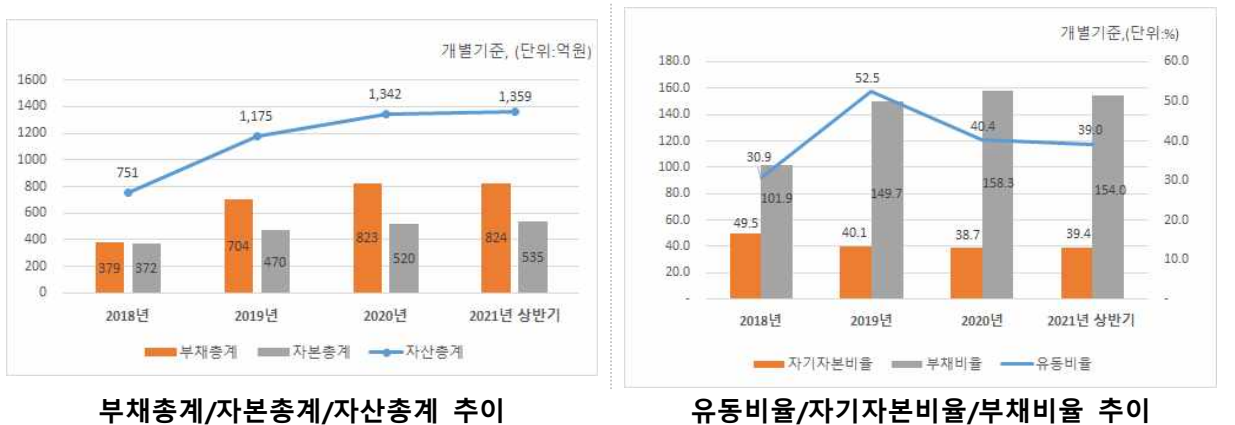
이는 2020년도 NICE 산업평균 매출액영업이익률인 14.2%와 비교했을 때 다소 미흡한 수준이다. 다만 투하자본 대비 수익창출력을 나타내는 총자본순이익률(ROA)의 경우 4.1%, 자기자본 대비 이익률인 ROE는 10.4%로 각각 NICE 산업평균 수치인 6.8%, 8.9%와 유사한 수준을 기록한 바, 전반적인 사업수익성과 자본효율성은 무난한 수준으로 평가된다.

■ 부진한 실적에도 양호한 재무안정성 유지

2021년 상반기 매출은 486억 원(-16.6% YoY)으로 내수 실적과 수출 모두 부진한 흐름을 나타내었다. 주요 고객사인 SK하이닉스향 매출도 전반기 449억 원에서 당반기 294억 원으로 감소한 것이 확인된다. 외형 축소에 따른 제반 고정비용 부담 확대와 매출원가 증가로 인해 매출액영업이익률 -7.2%, 매출액순이익률 -10.8%로 수익성도 적자 전환되었다.

한편 2021년 상반기 말 부채비율은 154.0%, 자기자본비율 39.4%, 차입금의존도 48.6%, 유동비율 39.0% 등으로 2020년 결산 시점과 유사한 재무안정성 지표를 기록했다. 전환사채의 일부가 보통주로 전환되었음에도 불구하고 순손실 기록에 따라 결손금이 누적된 탓이다. 당사는 금융부채 비중이 높고 유동비율이 낮아 동종업계 대비 재무구조가 미흡한 수준으로 평가된다.

그림 4. 동사 연간 및 상반기 요약 재무상태표 분석



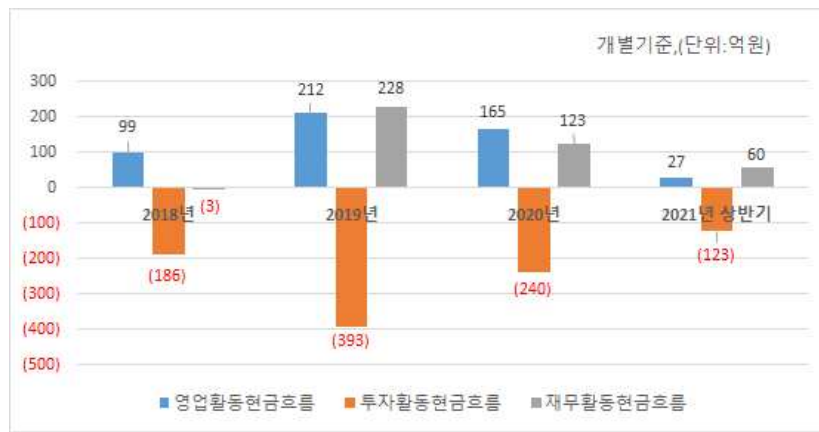
*출처: 동사 사업보고서(2020), 반기보고서(2021)

■ 시설투자로 인해 현금유출 지속

영업활동으로 인한 현금흐름은 2018년 99억 원, 2019년 212억 원, 2020년 165억 원, 2021년 상반기 27억 원으로 흑자 기조를 유지했다. 다만 기계장치와 같은 시설자산 취득에 매년 200-300억 원에 육박하는 현금유출이 이루어지고 있어 자금 부담이 상당하다. 영업창출현금으로 부족한 투자자금은 전환사채 발행 및 금융권 대출을 통해 융통하고 있다. 동사의 영업이익 이자보상비율은 2020년이 2.1배, 2019년이 3.4배, 2018년이 1.9배로 2020년 NICE 산업 평균인 27.9배 대비 열위하다.

한편 당반기 말 현금성자산은 73억 원으로 기초 110억 원 대비 감소하였다.

그림 5. 동사 현금흐름의 변화



Ⅲ. 주요 변동사항 및 전망

시스템 반도체로 사업영역 확장 및 고부가가치 패키징 관련 기술개발 진행

동사는 매출 다변화를 위해 시스템 반도체 테스트 분야로 사업영역을 확장하고 있으며, 기술 확보, 생산성 증대를 목적으로 지속적인 반도체 패키징 분야 기술개발을 통해 생산역량 강화에 집중하고 있다.

■ 주요 사업 이슈

동사는 사업영역 확장과 거래처 다변화를 위해 시스템 반도체 테스트 분야로 사업영역을 확장하고 있다. 시스템 반도체 산업은 각 제품의 특성에 맞는 다양한 반도체를 개발, 양산하는 방향으로 산업구조가 형성되고 있어, 각기 다른 제품의 양품과 불량품을 판별하는 테스트 전문 업체의 필요성이 대두되고 있는 상황에서 동사는 다양한 고객의 요구에 맞춰 테스트 라인을 증설, 확충하고 있다. 동사의 시스템 반도체 테스트 사업이 활성화되어 관련 기반을 확보할 경우 팹리스 업체들의 칩을 패키징부터 테스트까지 일괄 수주가 가능할 것으로 전망된다.

그림 6. 제품 개발 로드맵



*출처: IR자료(2020)

■ 기술에 대한 전망

그동안 반도체 소자 분야는 미세 스케일링을 통해 집적도를 높이고 성능을 개선하는 방식으로 발전해 왔으나, 이러한 방식은 설계 및 제조 공정에서 높은 난이도와 비용을 수반하여 한계에 다다르고 있다. 이에 저전력, 고집적, 고성능 구동 조건을 충족하는 패키징 기술이 부각되고 있다.

최근 대부분의 전자기기는 다기능의 반도체가 요구되어 이를 구현하기 위한 개별 소자들의 단일 패키징 기술이 필요하며, 가격경쟁력 확보를 위해서는 이러한 패키징 공정의 고도화가 필요하다. 패키징 공정은 전통적 리드프레임 방식에서 솔더볼과 범프 등을 이용한 BGA, FC 등 기술을 거쳐 현재는 FO-WLP, TSV 등 기술로 패러다임이 전환되고 있으며, 이러한 고집적, 다기능 구현을 위한 첨단 패키징 기술은 부품 수율과 시스템 전체에 대한 높은 이해도가 요구되는 기술집약적 산업으로 발전하고 있다.

그림 7. 패키징 기술의 변화



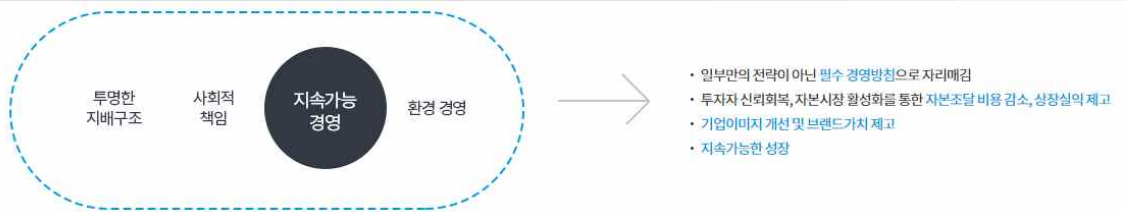
*출처: 반도체 후공정(패키징), 한국과학기술기획평가원(2020)

동사는 패키징 및 테스트 수율을 확보하면서도 호환성을 높이기 위한 공정기술을 개발하고 있다. 고객사가 요구하는 제품 스펙에 따라 패키징의 초기형태인 Lead frame 방식부터 최신형 모바일 기기에 적용되는 substrate 방식의 MCP까지 다양한 방식의 패키징을 진행하고 있다. 사업 초기에는 BOC 형태의 패키징을 주로 진행하였고 이후 COB, MCP, 응용복합제품(CI-MCP, E-NAND), 센서제품, T-CON, POP, eMMC, Flip Chip 등의 형태로 다각화했으며 2차, 3차 품질검사를 통해 수율 향상과 호환성 확보에 노력하고 있다.

■ ESG 활동 현황

ESG는 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻한다. ESG 평가는 기업엔 지속 가능 경영의 동기를 유발하고 투자자에게는 사회적 책임투자에 대한 접근성을 제고하는 지표로 활용할 수 있다. 국내 ESG 평가를 수행하고 있는 기관은 한국기업지배구조원, 서스틴베스트, QESG 가 있다.

그림 8. ESG



*출처: 한국기업지배구조원 홈페이지(2021)

동사는 홈페이지에 환경방침을 공개하고 있으며, 환경경영시스템 확립 및 환경, 안전, 보건 활동에 적극 참여, 교육훈련 수준을 지속적으로 향상, 지속적인 환경개선활동 및 환경오염 예방 활동, 지구온난화 방지에 기여, 분쟁 광물이 사용되지 않는지 확인 등을 약속하고 있다.


그림 9. 환경방침

- 회사와 지역사회에 적합한 환경경영시스템 확립 및 환경, 안전, 보건 활동에 적극 참여한다.
- 환경, 안전, 보건에 대한 국내외 법규준수 및 체계적인 교육훈련 수준을 지속적으로 향상시킨다.
- 환경영향을 최소화하기 위한 지속적인 환경개선활동 및 환경오염 예방 활동에 최선을 다한다.
- 에너지사용 최적화 및 원부자재, 수자원의 사용을 최소화하여 지구온난화 방지에 기여한다.
- 공급망에 콩고 민주 공화국의 및 인접 국가에서 추출된 분쟁 광물이 사용되지 않는지 확인한다.

*출처: 동사 홈페이지(2021)

동사는 환경부문에 해당하는 환경경영시스템 인증인 ISO 14001:2004를 보유하여 모든 업무를 수립된 절차에 따라 수행하고 있으며, 품질을 보증, 유지하고 있다. 특히, 별도의 에너지환경팀을 운영하고 있으며, 관련 인력을 채용하여 환경경영시스템 운영, 온실가스 목표 관리제 운용, 초순수/폐수 관리 등을 진행하고 있다.

표 5. 보유 인증 현황

인증명	기간	상태
 ISO14001:2004	2006-05-26~	유효

*출처: 한국생산성본부 인증원(2021), NICE평가정보(주) 재구성

또한, ‘DRC Conflict-Free’ 를 실행하고 있다. ‘DRC Conflict-Free’ 의 정의는 콩고 민주공화국(DRC) 혹은 DRC 주변 국가(수단, 우간다, 르완다, 부룬디, 탄자니아, 앙골라, 중앙아프리카)의 무장단체에 지원을 하거나 혜택이 되어서는 안 되는 제품을 의미하고, 당사는 이 정책을 준수하고 있다.

2021년 반기보고서 기준, 기간제 근로자는 없으며, 여성 근로자는 146명으로 총 462명의 임직원이 근무하고 있고 인권 보호 정책을 운용하고 있다. 다만, 협력사 지원 프로그램, 공정거래/반부패 프로그램, 소비자 안전 관련 인증, 정보보호 안전 관련 인증, 사회공헌 프로그램 등 사회책임경영에 관한 활동이 확대되어야 할 것으로 사료된다.

표 6. 여성/기간제 근로자 근무 현황

사업 부문	성별	기간의 정함이 없는 근로자	기간제 근로자	합계
반도체 임가공	남	310	-	310
	여	146	-	146
합계		462	-	462

*출처: 반기보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

지배구조 부문은 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 정기주주총회(제19기)에 전자투표제를 실시한 이력이 있고 총 6명의 이사 중 2명의 사외이사를 보유하여 이사회 내 사외이사 비중이 30% 이상으로 이사회 독립성을 확보하고 있다. 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선정하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있다. 또한, 계열회사 지분 표를 공시함으로써 지배구조 정보를 공개하고 있는 것으로 보인다.

■ 증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
<ul style="list-style-type: none"> • 최근 6개월 이내 발간 보고서 없음 			

■ 시장정보(주가 및 거래량)



*출처: Kisvalue(2021.10)